



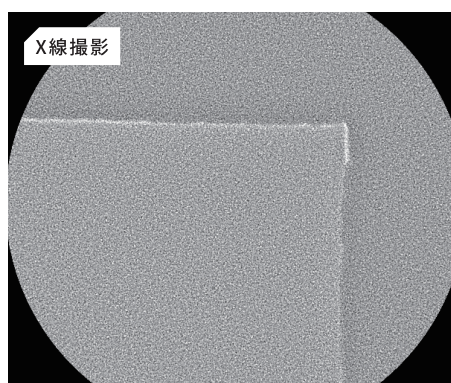
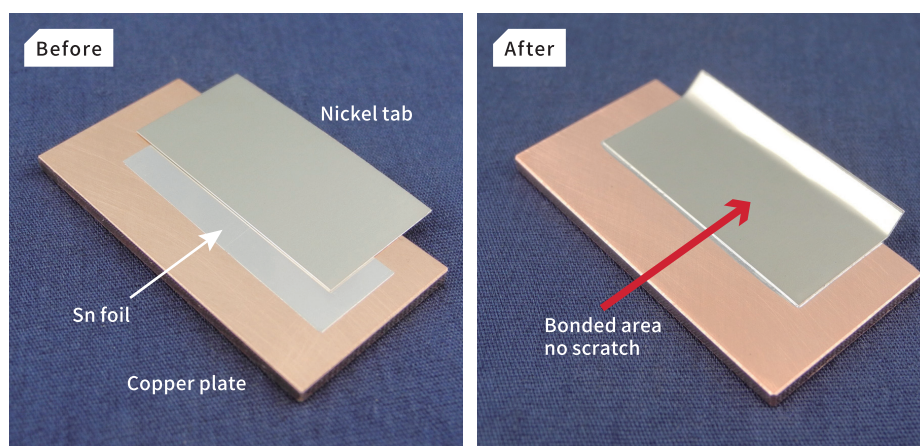
Patented

Application

Bonding ボンディング

ニッケルタブと銅板の音波接合

サウンドパワーのボイド排出効果による綺麗な合金接合



Product used 使用する装置

15MZs



AP-J-0041A4-2021111501